

**SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED**  
**HIGH EFFICIENCY SILICON RECTIFIER**  
**VOLTAGE RANGE 50 to 100 Volts CURRENT 2.0 Amperes**

**FEATURES**

- \* Glass passivated device
- \* Ideal for surface mounted applications
- \* Low leakage current
- \* Metallurgically bonded construction
- \* Mounting position: Any
- \* Weight: 0.098 gram

**MECHANICAL DATA**

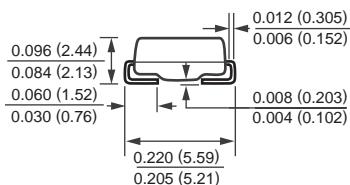
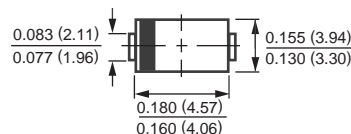
- \* Epoxy : Device has UL flammability classification 94V-0

**MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.  
 Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.  
 For capacitive load, derate current by 20%.



**DO-214AA**



Dimensions in inches and (millimeters)

**MAXIMUM RATINGS** (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	HFM201	HFM202	HFM203	HFM204	HFM205	HFM206	HFM207	HFM208	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	50	100	200	300	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Volts	VRMS	35	70	140	210	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	Vdc	50	100	200	300	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Current at TA = 55°C	Io	2.0								Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	60								Amps
Typical Junction Capacitance (Note 2)	Cj	30					20			pF
Operating and Storage Temperature Range	TJ, TSTG	-55 to + 150								°C

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS** (At TA = 25°C unless otherwise noted)

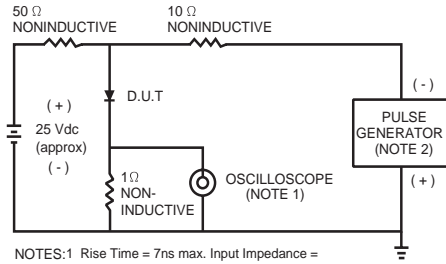
CHARACTERISTICS	SYMBOL	HFM201	HFM202	HFM203	HFM204	HFM205	HFM206	HFM207	HFM208	UNITS
Maximum Forward Voltage at 2.0A DC	Vf	1.0			1.3		1.7			Volts
Maximum Full Load Reverse Current, Full cycle Average TA = 55°C	Ir	50								uAmps
Maximum DC Reverse Current at @ TA = 25°C		5.0								uAmps
Rated DC Blocking Voltage @ TA = 125°C		100								uAmps
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)	trr	50					75			nSec

NOTES : 1. Test Conditions: IF=0.5A, IR=-1.0A, IRR=-0.25A.

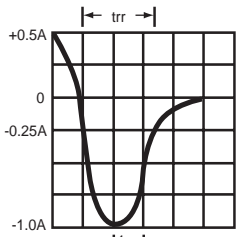
2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.

# RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( HFM201 THRU HFM208 )

FIG. 1 - TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC

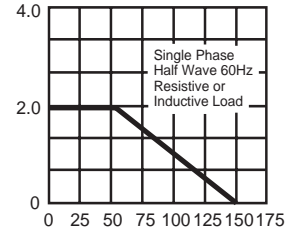


NOTES: 1 Rise Time = 7ns max. Input Impedance = 1 megohm. 22pF.  
2. Rise Time = 10ns max. Source Impedance = 50 ohms.



SET TIME BASE FOR 10/20 ns/cm

FIG. 2 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE



Single Phase Half Wave 60Hz Resistive or Inductive Load

FIG. 3 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

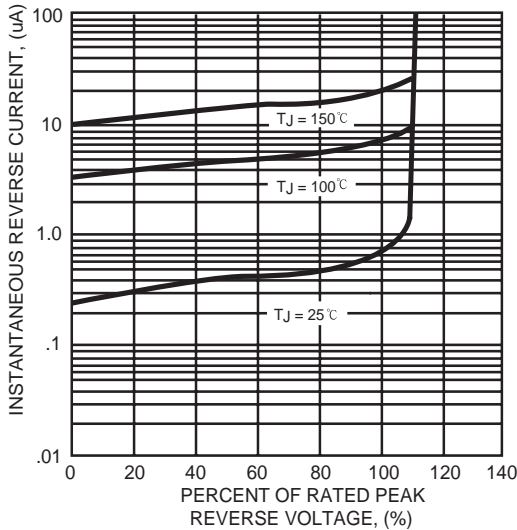


FIG. 4 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

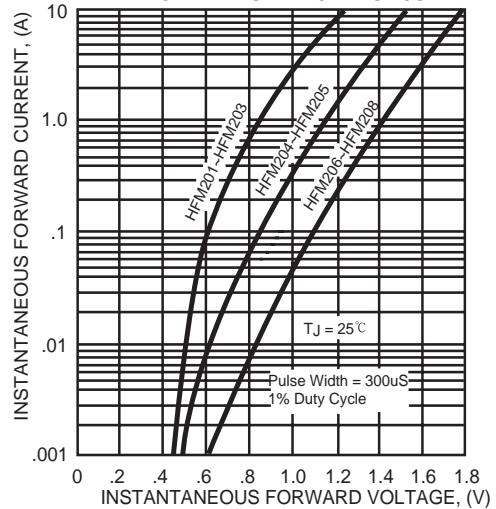


FIG. 5 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

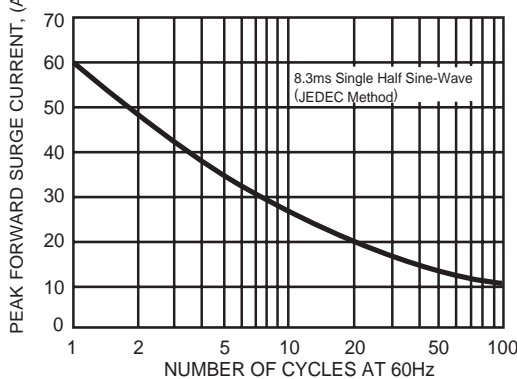
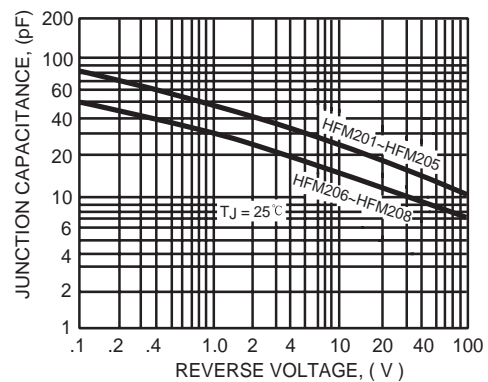
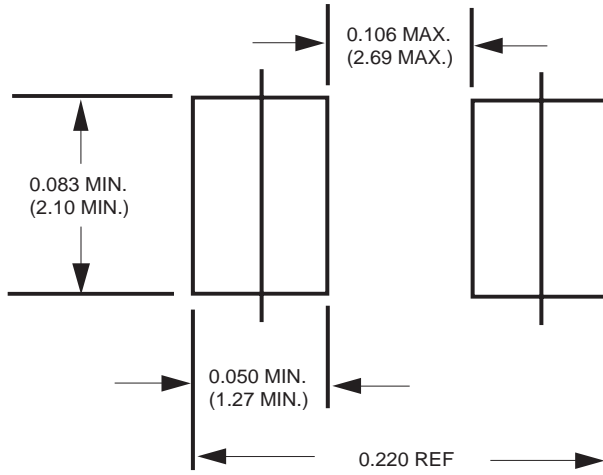


FIG. 6 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



## Mounting Pad Layout



Dimensions in inches and (millimeters)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.

